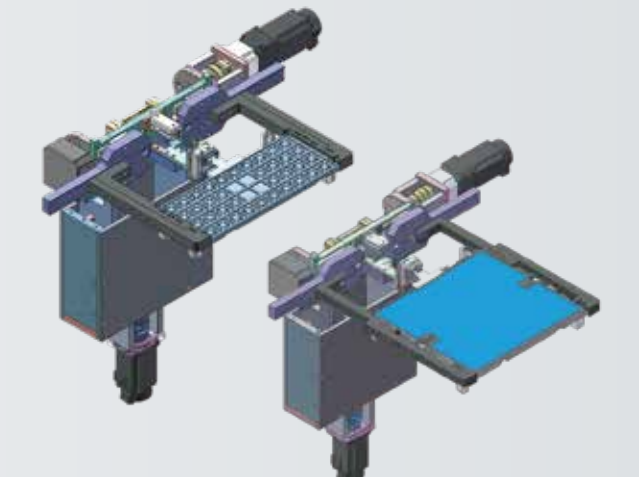


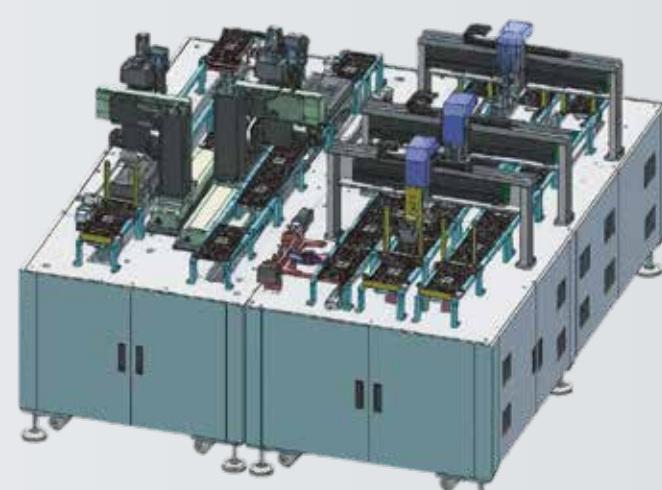
Orca series



※本画像は参考用であり、予告なく変更される場合があります。
The illustration is for reference and subject to change without notice

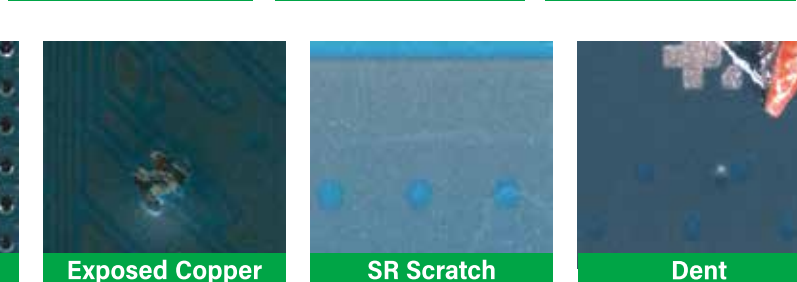


可変レール: JEDEC Small Tray及び
JEDEC Large Trayに対応可能



Nidec Super Vision (S-Vision) Imaging System

Defect Samples



■単一スキャンで異なる光学効果を持つ
複数のフルカラー画像を生成
Single scan generates multiple full-color
images with different optical effects

■撮像効率が 2~3 倍に向上*
Imaging efficiency increased 2-3x

■マルチチャンネル・独立光学系を採用
Multi-channel, independent optical paths

*1回のスキャンで3チャンネルの画像を同時取得可能。
Enabled by generating 3 optical channels in a single scan.

■AI+従来CVの先端アルゴリズムと豊富な欠陥ライブラリで、
欠陥を高精度に分類・解析。

Advanced AI + CV algorithms and a rich defect library
enable precise defect classification and analysis.

■独自開発のフルスペクトル多次元光源システムを採用し、
高精度検査のために最適化。

A self-developed full-spectrum, multi-dimensional lighting system
customized for high-precision inspection.

■JEDEC Small TrayとLarge Trayの双方に対応し、
業界の大判化・自動搬送高度化の流れにしっかりと適合。

Compatible with both JEDEC Small and Large Trays, aligning with the industry's shift
toward larger formats and high-efficiency automated handling.

■良率の変動をリアルタイムで監視し、ライン判断を支援。
品質管理と良率改善をスマートに実現。

Real-time yield monitoring supports production decisions,
enabling intelligent quality control and yield improvement.

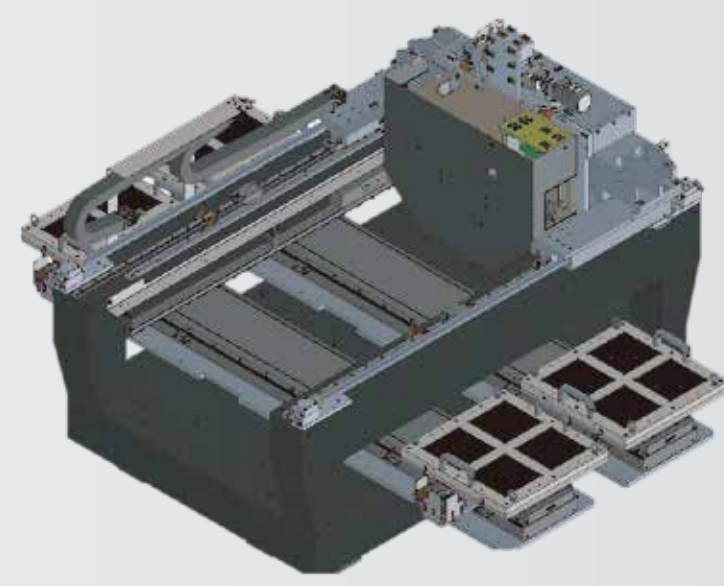
AFVI+AI Specifications

装置寸法 Machine Size	可変レール: 4500 × 3800 × 1860mm (L×W×H) ※三色灯を除く Variable rail: 4500 × 3800 × 1860mm (L×W×H) ※Tri-color tower light not included.
対応可能サイズ Product Size	JEDEC Small Tray: 322.6×135.9mm JEDEC Large Tray: 537.6×258mm
光学パラメータ Visual Parameter	CCD: 3.5μm/2.5μm resolution; 16K color high-speed line scan; Robust Light Source
検出可能な欠陥 Defect Type	変色、クラック、露銅、スクラッチ、異物、打痕、ノッチ、エッチング不良、汚染など Discoloration, cracks, exposed copper, scratches, foreign matter, dents, notches etching defects, contamination, etc
サイクルタイム Cycle Time	JEDEC Small Tray: ≥60 tray/hr (分解能3.5μm) JEDEC Large Tray: ≥45 tray/hr (分解能3.5μm)

RSH series



※本画像は参考用であり、予告なく変更される場合があります。
The illustration is for reference and subject to change without notice



※対応ワークサイズ
2Lane : ~□330mm
1Lane : ~□650mm

■高精度・高分解能のままコストを最適化

高解像度検査と高精度な測定性能を両立。
High Precision&Resolution

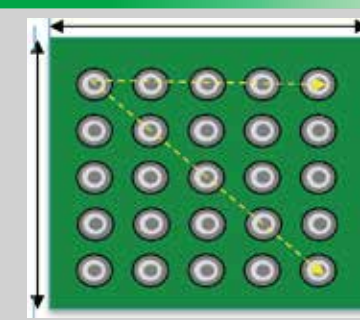
■大型基板・高密度バンパに完全対応

より大きな基板や多数のバンパ、小径バンパや狭ピッチ、
さらに様々なバンパ形状・方向にも柔軟に対応可能。
Fully Compatible with Large Substrates&High-Density Bumps.

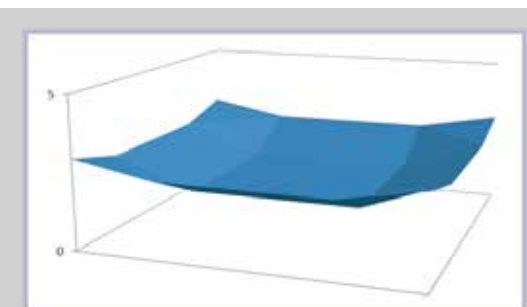
■最先端のソフトウェア&アルゴリズム搭載

マルチコアや先端パッケージ向けTTV/STV計測など、強力な解析機能を搭載。
Equipped with Cutting-Edge Software and Algorithms.

3D/2D Bump Metrology



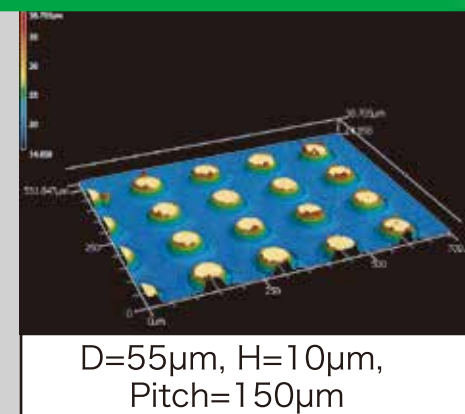
Large Body Size



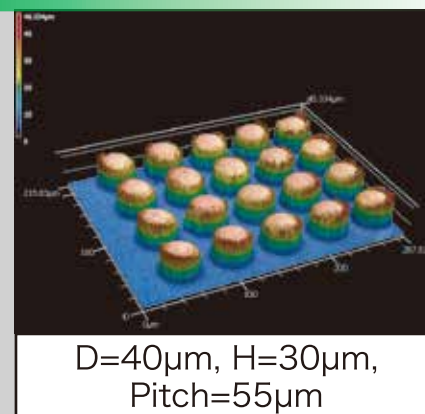
Warpage

Fine Pitch Bump Measurement

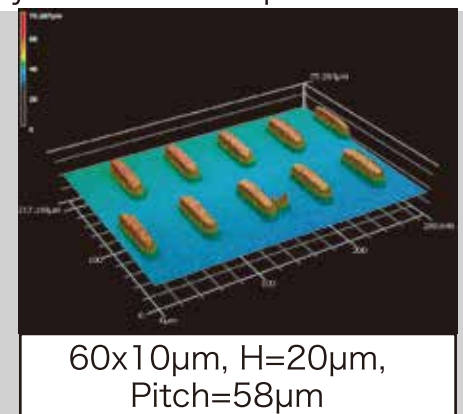
※Keyence microscope



D=55μm, H=10μm,
Pitch=150μm



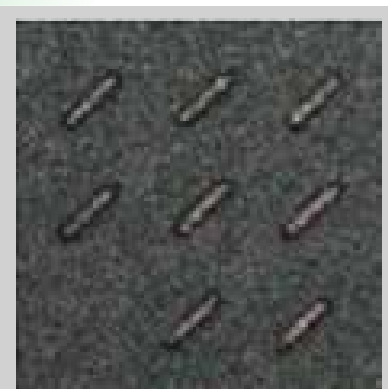
D=40μm, H=30μm,
Pitch=55μm



60x10μm, H=20μm,
Pitch=58μm

Various Bump Shapes and Orientations

※Keyence Optical+Laser (10X)



2D/3D Bump Inspection Specification

Product Size	JEDEC Small Tray / JEDEC Large Tray / Full Panel
FOV	9.6mm
Resolution	2D(X): 1.83μm, 2D(Y): 1.83μm; 3D(X): 5μm, 3D(Y): Programmable, 3D(Z): 0.11μm
Min. Bump Size	20μm
Min. Bump Pitch	1.4x bump height
Applications	C4 area bump measurement Bump height, bump diameter, bump coplanarity, CAW, etc.

※以上はRSH-8iFの仕様に基づきます。The above specifications are based on the RSH-8iF model.

国内拠点

・京都(本社)
617-0003 京都府向日市森本町東ノ口1-1 ニデックパークC棟
TEL 075-280-8101 / FAX 075-280-8106
・名古屋
503-0974 岐阜県大垣市久瀬川町1-3
TEL 0584-83-7680 / FAX 0584-83-7685
・東京
141-0032 東京都品川区大崎1丁目20番13号 Nidec東京ビル
TEL 03-3494-7970 / FAX 03-3494-0793

海外拠点

・台湾 NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY TAIWAN CORPORATION
・韓国 NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY KOREA CO., LTD.
・中国 NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY ZHEJIANG CORPORATION
・タイ NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY THAILAND CO., LTD.
・マレーシア NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.
・ベトナム NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD.
・インド NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED
・カナダ NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY CANADA CORPORATION